



**AIXTRON**

**11. ordentliche Hauptversammlung**

14. Mai 2008

Eurogress Aachen

**AIXTRON**



**AIXTRON**

# **11. ordentliche Hauptversammlung**

## **TOP 1**

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2007 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007 und des Berichts des Aufsichtsrats



**AIXTRON**

# Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie „können“, „werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ und „schätzen“, Abwandlungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die nachgenannten Faktoren ebenso wie die weiteren in den von AIXTRON bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten öffentlichen Berichten und Meldungen genannten gehören zu denjenigen Faktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen und künftigen Ergebnisse und Trends wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge; der Umfang der Marktnachfrage nach Chemical Vapor Deposition (CVD)-Technologie; der Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden; das Finanzmarktklima und die Zugangsmöglichkeiten zu Finanzierungen; die allgemeinen Marktbedingungen für Dünnschichtungs-Anlagen und das makroökonomische Umfeld; Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen; Einschränkungen der Produktionskapazität; lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen; Schwierigkeiten im Produktionsprozess; Veränderungen beim Wachstum der Halbleiterindustrie; Verschärfung des Wettbewerbs; Wechselkursschwankungen; Verfügbarkeit öffentlicher Mittel; Zinsschwankungen bzw. verfügbare Zinskonditionen; Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte; schlechtere allgemeine wirtschaftliche Bedingungen als erwartet und sonstige Faktoren. Die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit im Zeitpunkt dieser Mitteilung, und AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, ausgenommen bei Bestehen einer entsprechenden rechtlichen Verpflichtung.

## Das Jahr 2007 – Die Highlights

*push your*   
**PERFORMANCE**

- Modernste LED-Anwendungen treiben Auftragseingang um 39%
- Verbesserter Marktanteil [ca.70%] infolge neuer Produkte
- Auftragseingang und -bestand steigen im Jahresverlauf stetig an
- Erhöhte Produktionskapazität ermöglicht 25% Umsatzwachstum
- EBIT-Steigerung um 261% im Jahresvergleich
- Liquide Mittel steigen um 54% im Jahresvergleich
- Hervorragende Aktienkursentwicklung: +185% in 2007

# Überblick

- **AIXTRON – Das Unternehmen**
- Operative Performance 2007
- Finanzielle Performance 2007
- Aktienkurs und Ausblick

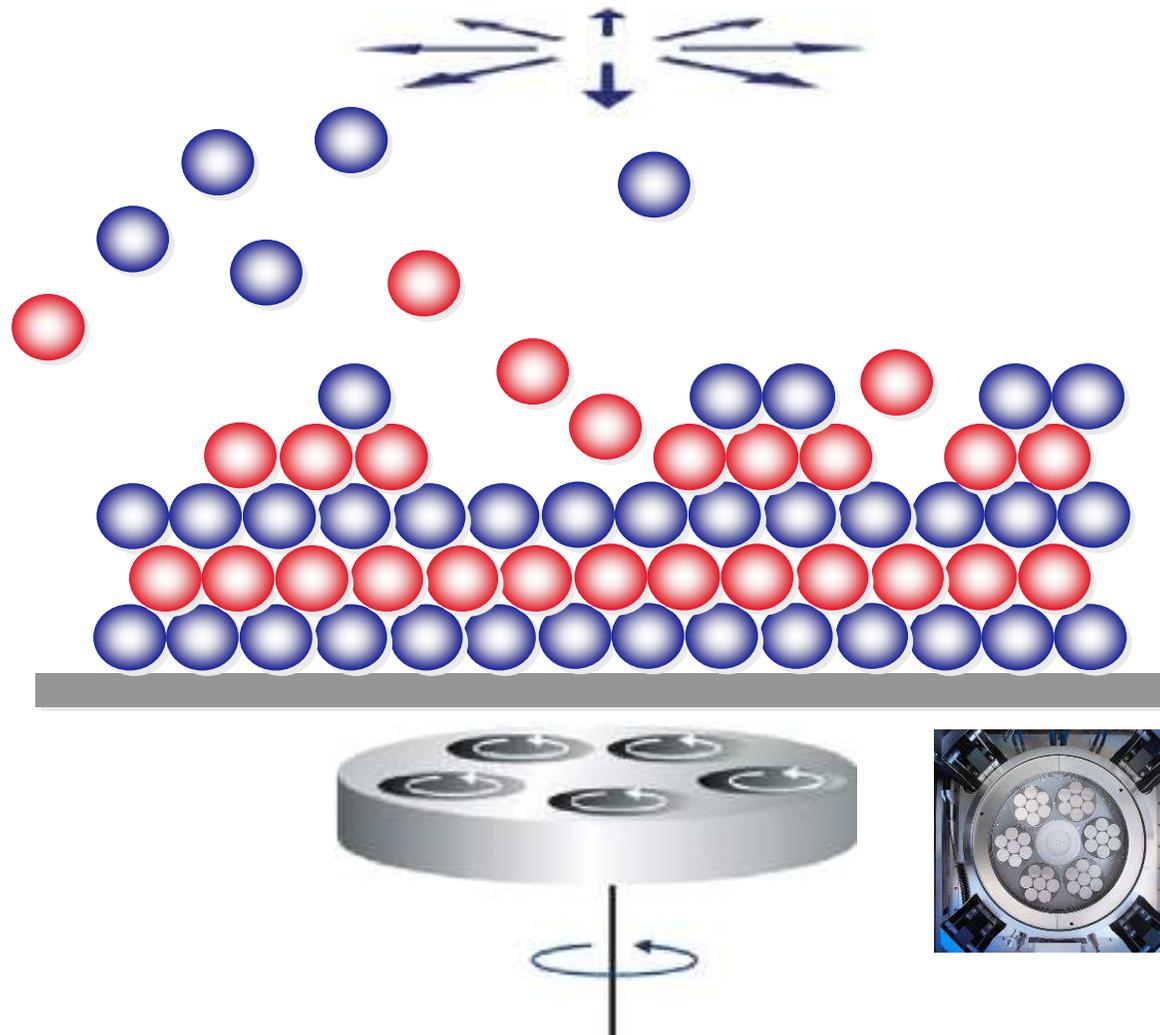
*push your*   
**PERFORMANCE**

# AIXTRON Globale Präsenz



# Gasphasenabscheidung

Materialbearbeitung auf atomarer Ebene



# Eine Technologie – Viele Anwendungen

<b>Technologie</b>	<b>Gasphasenabscheidung Materialtechnik im Nanobereich</b>	
<b>Verfahren</b>	<b>Verbindungshalbleiter MOCVD, OVPD®</b>	<b>Siliziumhalbleiter AVD®, ALD, CVD</b>
<b>Anwen- dungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs/OLEDs für Bildschirme</li> <li>• LEDs/OLEDs für Beleuchtung</li> <li>• Optoelektronik für Datenübertragung/Telefonie</li> <li>• Organische Elektronik für flexible Displays und RFID</li> <li>• CD-, DVD-Laser</li> <li>• Hochfrequenzeinheiten für drahtlose Telefonie</li> <li>• SiC-Hochstromeinheiten</li> <li>• III-V-Halbleiter- und organische Solarzellen</li> <li>• Kohlenstoff-Nanoröhren Anwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall und Oxid-schichten für CMOS Steuerelektroden</li> <li>• Traditionelle NAND-Flash Speicher</li> <li>• Traditionelle DRAMs und DRAMs der nächsten Generation</li> <li>• TFH – Dünnschichtleseköpfe für Festplatten-datenspeicher</li> </ul>

# Positionierung in der Wertschöpfungskette



**AIXTRON**

**Veeco**

**ASM**  
The Process of Innovation™

**APPLIED MATERIALS™**

**SAMSUNG**

**intel.**

**hynix**  
Semiconductor

**EPISTAR corporation**  
晶元光電 股份有限公司

**LUMILEDS**  
LIGHT FROM SILICON VALLEY

**OSRAM**  
Opto Semiconductors

**SAMSUNG**

**SONY**

**MOTOROLA**  
intelligence everywhere™

**NOKIA**  
CONNECTING PEOPLE

**hp**

invent

**CMO**

**AUO**

- Bildschirme
- Beleuchtung
- Unterhaltungselektronik
- Automobil
- Medizintechnik
- Industrie-anwendungen

# Überblick

- AIXTRON – Das Unternehmen
- **Operative Performance 2007**
- Finanzielle Performance 2007
- Aktienkurs und Ausblick

*push your*   
**PERFORMANCE**

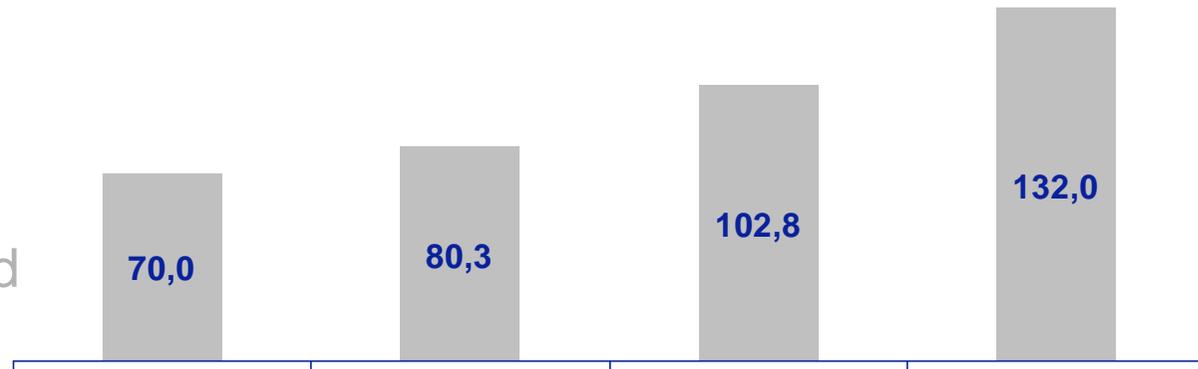
# Quartalsweise Geschäftsentwicklung 2007

(Mio. €)

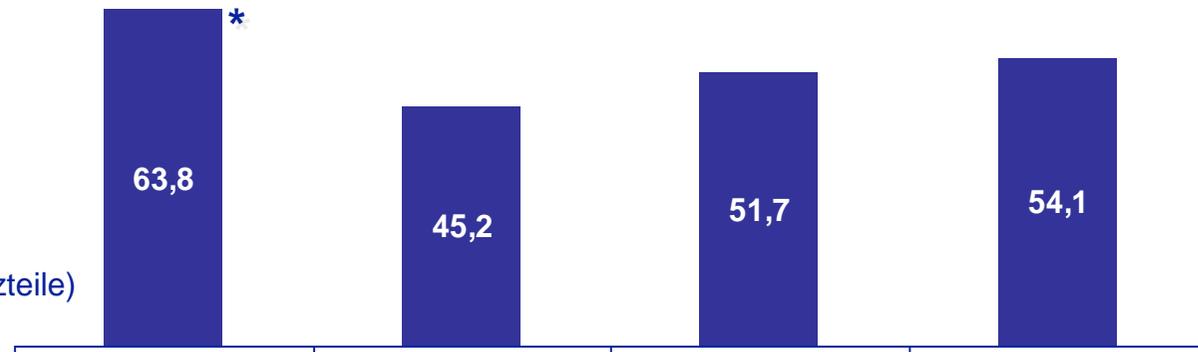
**Auftragseingang**  
(nur Anlagen)



**Auftragsbestand**  
(nur Anlagen)



**Gesamtumsatz**  
(einschl. Service u. Ersatzteile)



\* Rekord-Quartale

Q1/2007

Q2/2007

Q3/2007

Q4/2007

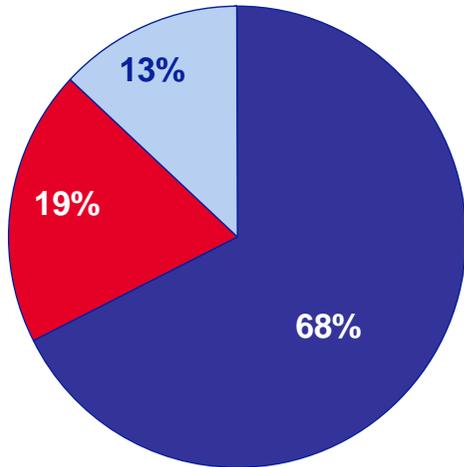
# Geschäftsentwicklung 2007

	Verbindungshalbleiter (einschl. organischen HL)	Siliziumhalbleiter
Umsatzerlöse	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ €145,2 Mio. Anlagenumsätze<sup>1)</sup> (+50%)</li> <li>➤ 68% vom Gesamtumsatz<sup>2)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ €41,7 Mio. Anlagenumsätze<sup>1)</sup> (-9%)</li> <li>➤ 19% vom Gesamtumsatz<sup>2)</sup></li> </ul>
Anlagen Auftrags- eingang <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ €208,6 Mio. (+52.5%)</li> <li>➤ 84% des gesamten Auftragseingangs<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ €39,1 Mio. (-5%)</li> <li>➤ 16% des gesamten Auftragseingangs<sup>1)</sup></li> </ul>
Haupttreiber	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mehrfach- &amp; Wiederholungsbestellungen bei plattformbasierten Anlagen</li> <li>➤ Weiße LEDs für Hintergrundbeleuchtung</li> <li>➤ Neue RGB-Anwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Härter umkämpfter Markt für Speicherprodukte</li> <li>➤ ALD und AVD<sup>®</sup> Initiativen stoßen auf höheres Kundeninteresse</li> </ul>

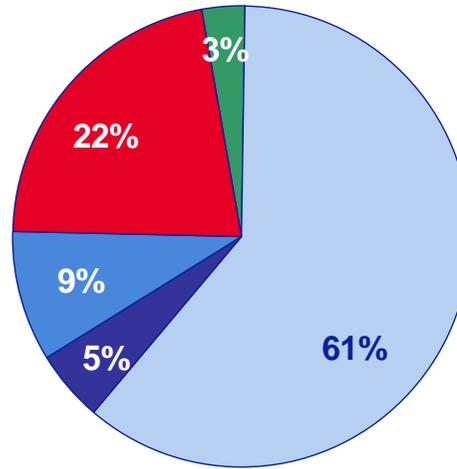
1) Ohne Service u. Ersatzteile; 2) Einschl. Service u. Ersatzteile

# 2007 Umsatz-Aufteilung

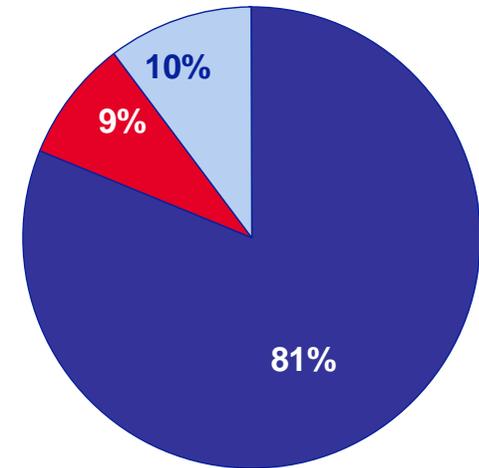
nach Technologie



nach Anwendungen



nach Regionen



- |                        |                               |        |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| Verbindungshalbleiter  | LED                           | Asien  |
| Siliziumhalbleiter     | Anzeigen u. Sonstiges         | Europa |
| Service u. Ersatzteile | Unterhaltungs-/Optoelektronik | USA    |
|                        | Telekom/Datakom               |        |
|                        | Silizium                      |        |

## Plattformbasierte Produktionsanlagen für Verbindungshalbleiter

- Hohe Kundenakzeptanz
- Weltweit als Industriestandard anerkannt
- Erhöhte Produktionskapazität in 2007
- ca. 70% der Verbindungshalbleiter-Auftragseingänge 2007
- ca. 50% der Verbindungshalbleiter-Umsatzerlöse 2007

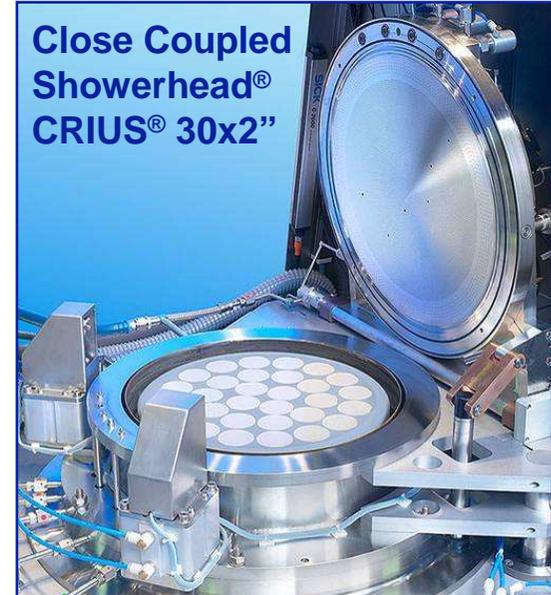
Integrated Concept (IC) System



Planetary Reactor® G4, 42x2''

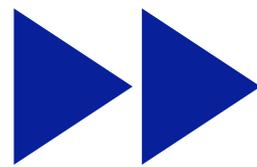
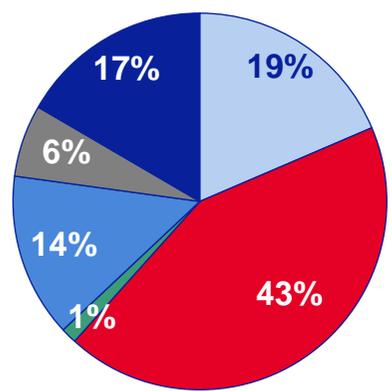


Close Coupled Showerhead® CRIUS® 30x2''

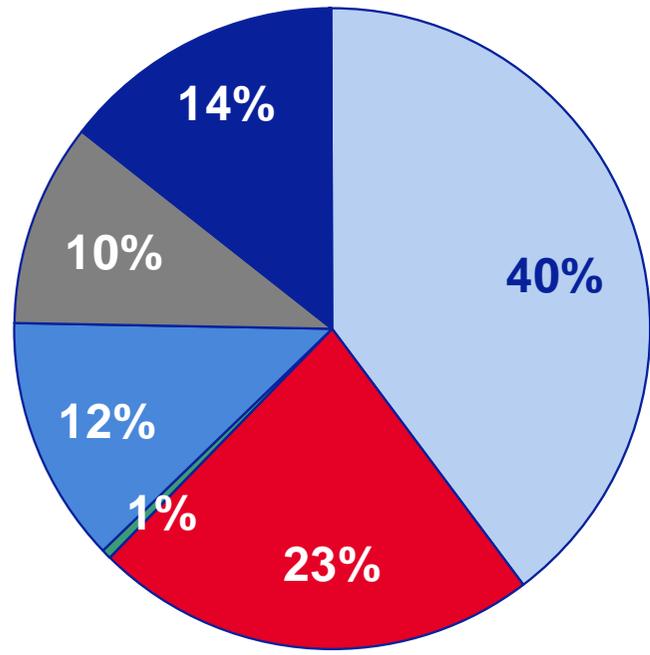


# Marktaussichten für ultrahelle LEDs

**2007**  
Gesamt: \$4,7 Mrd.



**2011**  
Gesamt: \$9,4 Mrd.



Anwendungen:

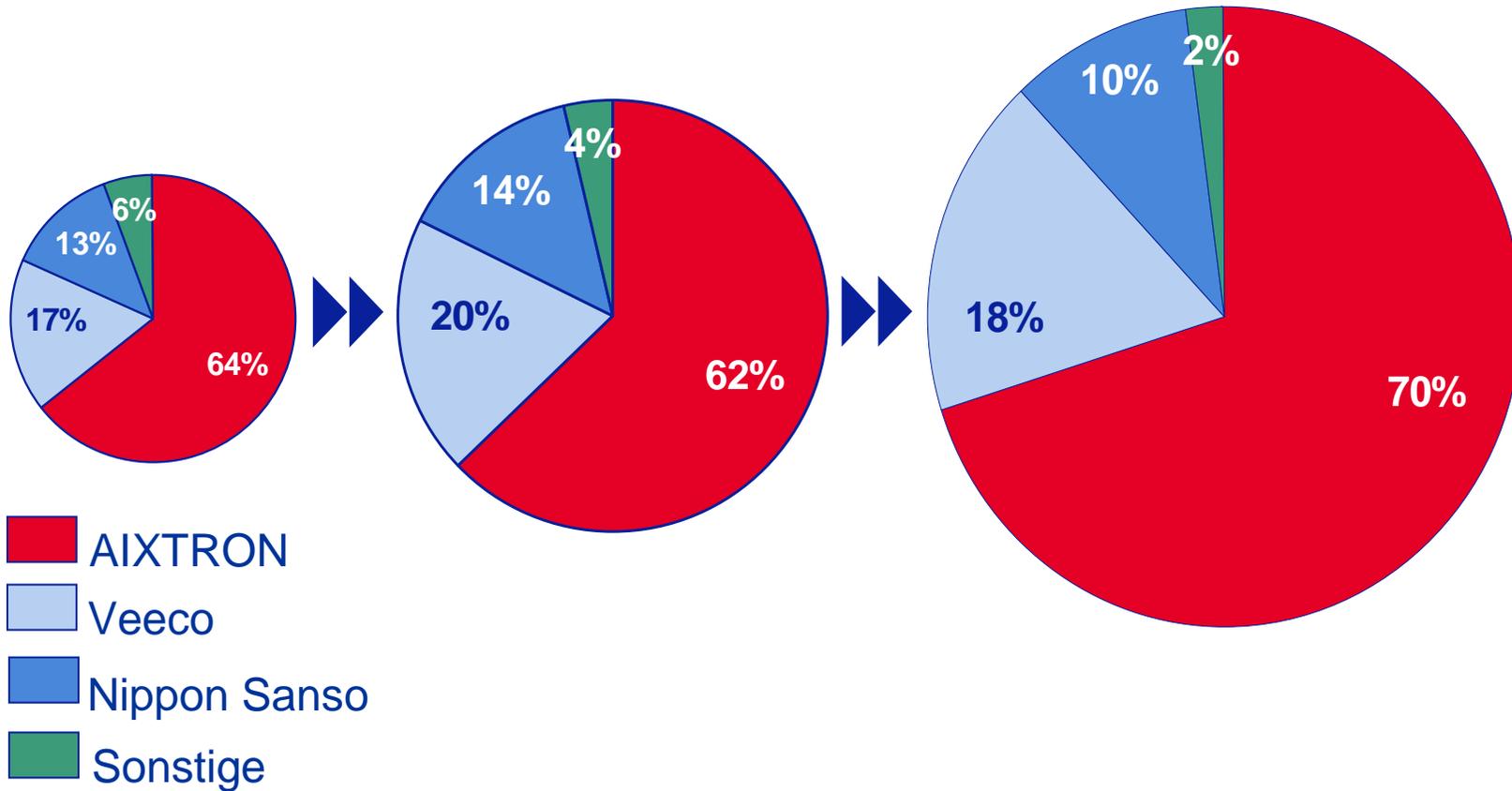
Anzeigen/Bildschirme	Automobil
Mobile Geräte	Beleuchtung
Signalanlagen	Elektronische Geräte/Sonstige

Quelle: Strategies Unlimited 2007

# MOCVD Weltmarktanteile

2005 Gesamt: \$156 Mio. 2006 Gesamt: \$202 Mio.

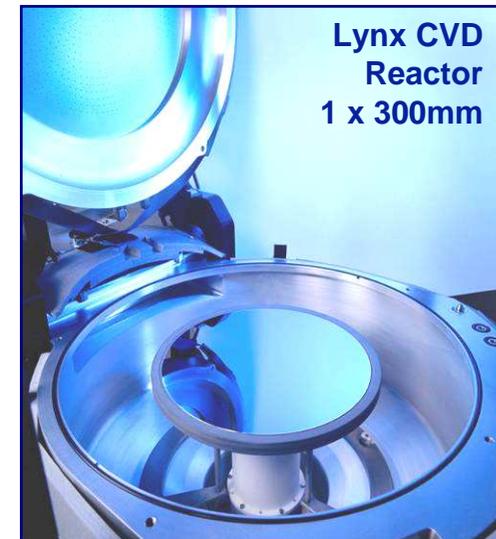
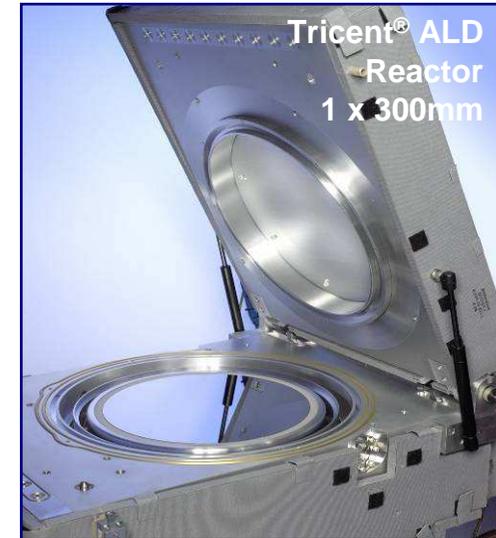
2007 Gesamt: \$289 Mio.



Quelle: VLSI RESEARCH Inc. 2008

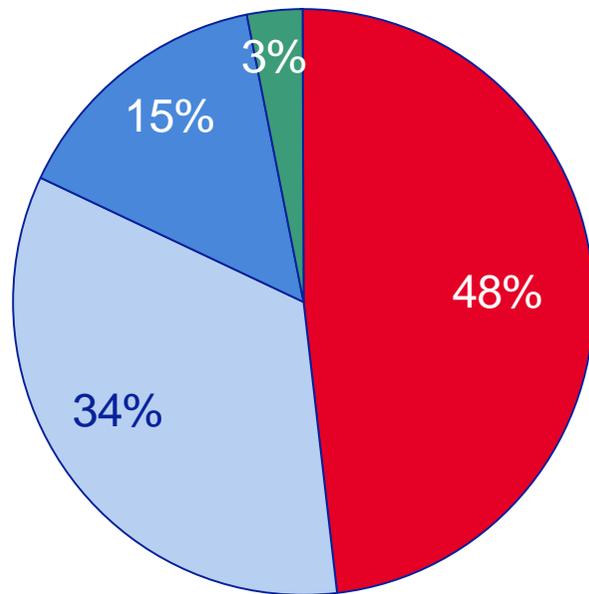
# Produktionsanlagen für Siliziumhalbleiter

- NAND Flash und DRAM Chips werden verstärkt in der Unterhaltungselektronik verwendet
- Umfassendes AIXTRON-Portfolio: CVD, ALD, AVD®
- Produktionsausbau bei etablierten CVD-Kunden
- ALD/AVD®: Qualifizierung für neue Materialien in Steuerelektroden/Kondensatoren
- Kombinierte ALD/AVD® Technologie - Entwicklungsprojekt mit führendem Hersteller in Asien

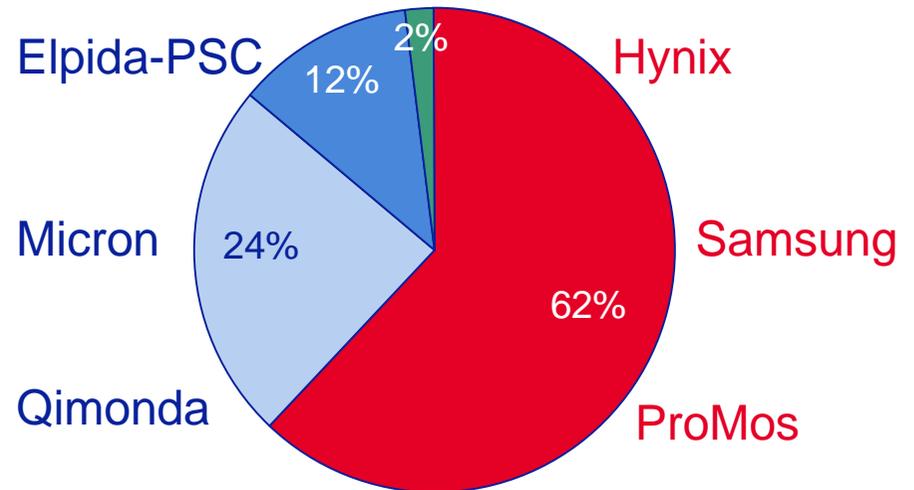


# CVD Weltmarktanteile für WSi<sub>x</sub>

2006  
Gesamt: \$109 Mio.



2007  
Gesamt: \$84 Mio.

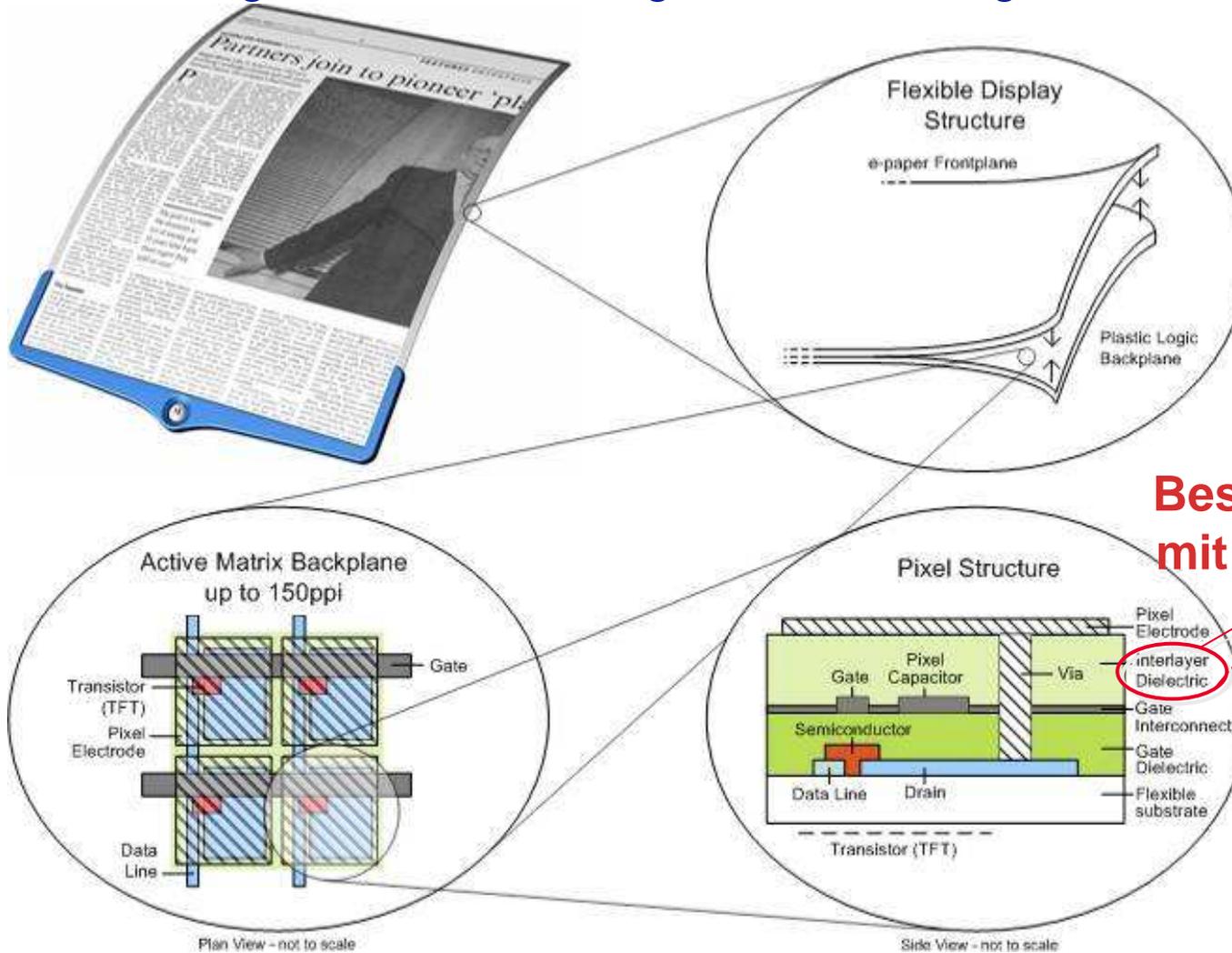


- AIXTRON
- Applied Materials
- Tokyo Electron
- Sonstige

based on VLSI RESEARCH Inc. 2008

# Neue Technologien – Neue Chancen

Entwicklung einer neuen Anlage für Plastic Logic: Plastikelektronik



Beschichtung  
mit AIXTRON  
Gen 3.5  
Anlage

# Neue Technologien – Neue Chancen

## Akquisition von Nanoinstruments, Ltd.: Kohlenstoff-Nanoröhren

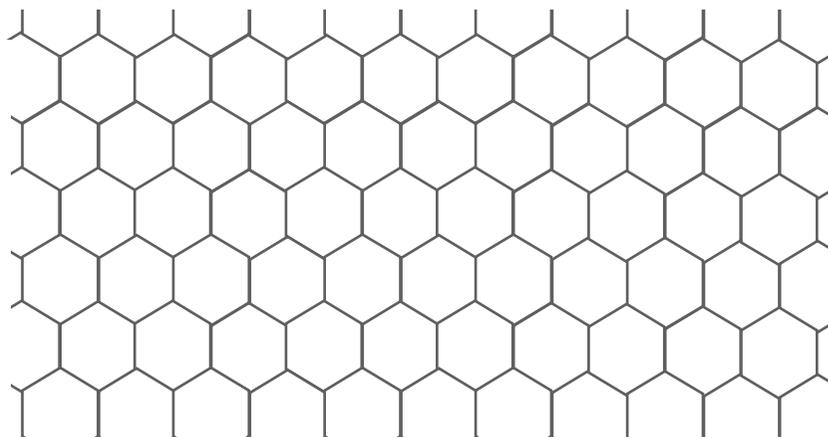
### Einzigartige Eigenschaften

- Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit
- Sehr hohe elektrische Leitfähigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit

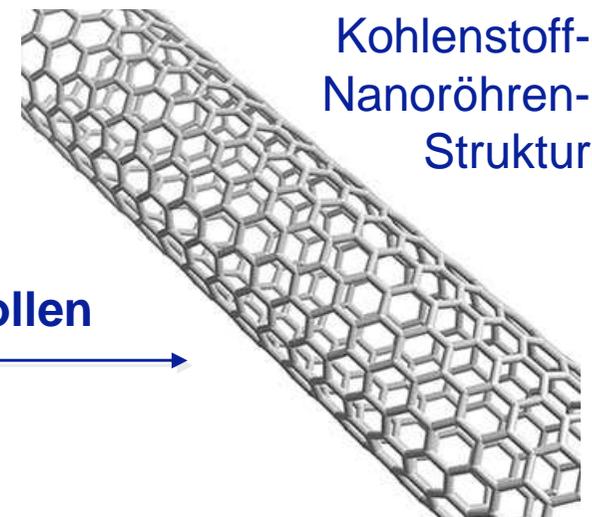
### Anwendungsbeispiele

- Elektronikbauteile
- Wärmeableitung
- Feldemissionsbildschirme

Graphitebene



Aufrollen



Kohlenstoff-Nanoröhren-Struktur

# Überblick

- AIXTRON – Das Unternehmen
- Operative Performance 2007
- **Finanzielle Performance 2007**
- Aktienkurs und Ausblick

*push your*   
**PERFORMANCE**

## Highlights Finanzdaten 2007

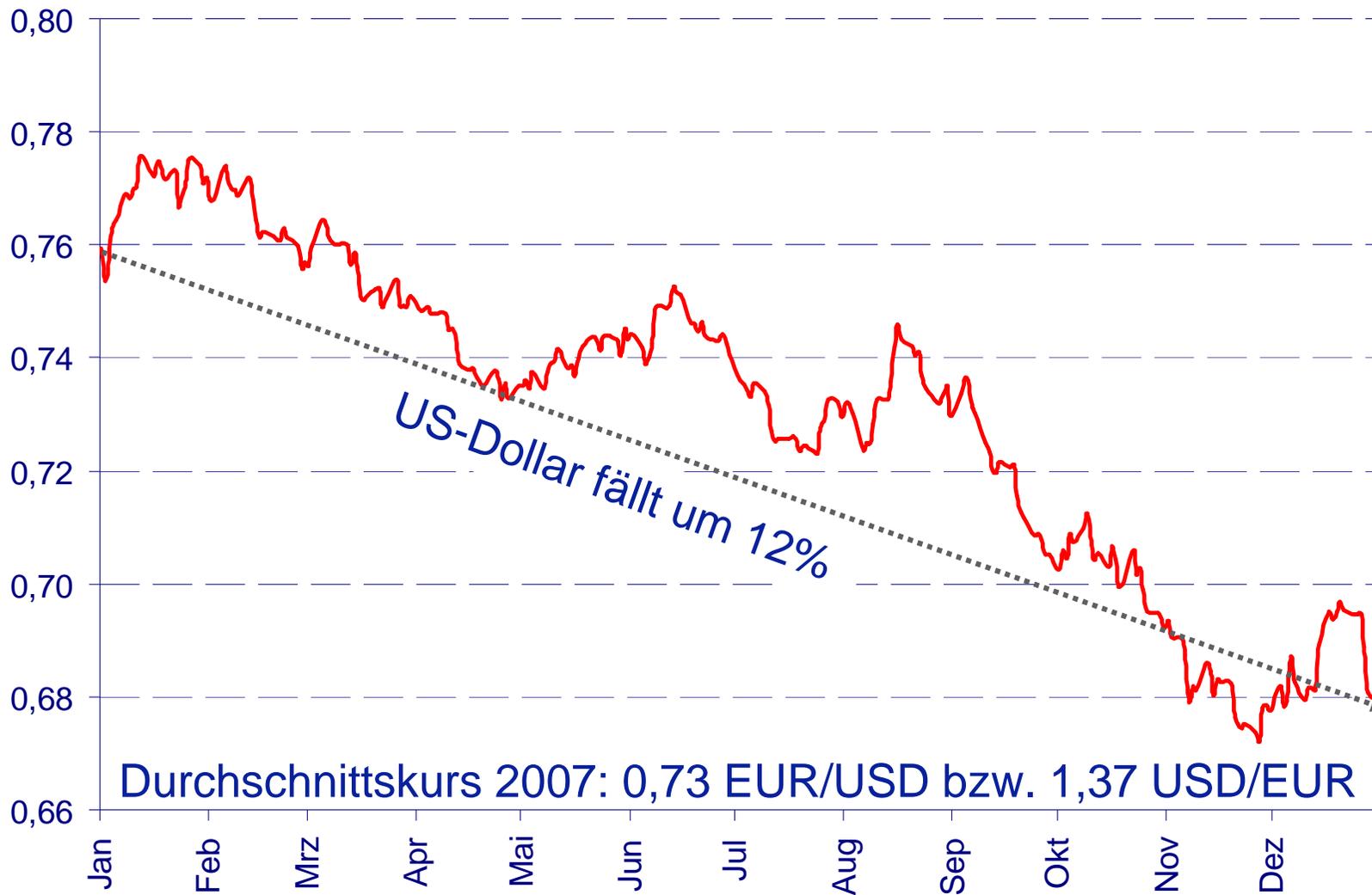
- **Gesamtumsatz steigt in 2007 um 25% auf €214,8 Mio.**  
(2006: € 171,7 Mio.)
- **Verbesserte Bruttomarge: 40% für das Gesamtjahr 2007**  
(2006: 37%)
- **EBIT steigt auf €20,6 Mio. bei 9,6% EBIT-Marge**  
(2006: €5,7 Mio. / 3,3%)
- **Anlagen-Auftragseingang steigt um 39% auf €247,7 Mio.**  
(2006: € 178,0 Mio.)
- **Auftragsbestand steigt um 55% auf €132,0 Mio.**  
(31.12.2006: €85,1 Mio.)
- **Liquide Mittel um 54% auf €71,9 Mio. erhöht**  
(31.12.2006: €46,8 Mio.)

## Eckdaten Konzern-Finanzlage 2007

(Mio. €)	2007	2006	Differenz
Anlagen-Auftragseingang	247,7	178,0	39%
Anlagen-Auftragsbestand (31.12.)	132,0	85,1	55%
Umsatzerlöse	214,8	171,7	25%
Bruttoergebnis	85,0	63,4	34%
Bruttomarge	40%	37%	+3pp
Betriebsergebnis EBIT	20,6	5,7	261%
EBIT-Marge	10%	3%	+7pp
Ergebnis nach Steuern	17,3	5,9	193%
Ergebnis pro Aktie (€)	0,20	0,07	186%
Liquide Mittel (31.12.)	71,9	46,8	54%
Zahlungsmittelzufluss (Free Cash Flow)	22,3	15,6	43%

# US-Dollarkurs 2007

EUR/USD



## Konzern-GuV 2007 (IFRS)

(Mio. €)	2007	2006	Differenz
Umsatzerlöse	214,8	171,7	25%
Herstellungskosten	129,8	108,3	20%
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>85,0</b>	<b>63,4</b>	<b>34%</b>
<b>Bruttomarge</b>	<b>40%</b>	<b>37%</b>	<b>+3pp</b>
Vertriebskosten	27,2	23,4	16%
Allgemeine Verwaltungskosten	16,0	17,3	-8%
Forschungs- u. Entwicklungskosten	26,5	23,9	11%
Sonstige betriebl. Erträge (Aufwendungen)	5,3	6,8	-22%
<b>Betriebsergebnis EBIT</b>	<b>20,6</b>	<b>5,6</b>	<b>268%</b>
<b>EBIT (% Umsatzerlöse)</b>	<b>10%</b>	<b>3%</b>	<b>+7pp</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>22,4</b>	<b>6,6</b>	<b>239%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern (% Umsatzerlöse)</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>	<b>+6pp</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>17,3</b>	<b>5,9</b>	<b>193%</b>
<b>Ergebnis nach Steuern (% Umsatzerlöse)</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>	<b>+5pp</b>

## Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

(Mio. €)	2007	2006
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus lfd. Geschäftstätigkeit	32,9	20,8
davon: Jahresfehlbetrag/-überschuss	17,3	5,9
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit	-10,5	-5,1
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Einfluss von Wechselkursveränderungen)	2,9	-0,3
Veränderung der Zahlungsmittel/-äquivalente	25,2	15,3
Zahlungsmittel/-äquivalente (Ende Berichtszeitraum)	71,9	46,8

# Konzernbilanz 2007 (IFRS)

(Mio. €)	31.12.2007	31.12.2006
Sachanlagen	35,1	36,4
Geschäfts-/Firmenwert	59,0	65,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	12,5	15,1
Sonstige	10,9	11,4
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>117,5</b>	<b>128,0</b>
Vorräte	60,0	53,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33,5	27,7
Sonstige	13,9	7,9
Liquide Mittel	71,9	46,8
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>179,3</b>	<b>135,5</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>198,4</b>	<b>183,9</b>
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23,8	29,9
Erhaltene Anzahlungen	50,0	31,4
Sonstige kurzfristige Schulden	22,2	15,2
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>96,0</b>	<b>76,5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>296,8</b>	<b>263,5</b>

## AIXTRON AG Eckdaten (HGB)

(Mio. €)	2007	2006	Differenz
Betriebliche Erträge	130,9	109,8	19%
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	10,9	2,8	289%
Gewinnvortrag	1,4	0,0	-
Einstellung andere Gewinnrücklagen	0,0	-1,4	-
Bilanzgewinn	12,3	1,4	-
2007 Vorschlag Dividendenzahlung	6,3	0,0	-
2007 Dividendenvorschlag pro Aktie (€)	0,07	0,00	-

## Eckdaten Konzern-Finanzlage 1. Quartal 2008

(Mio. € ungeprüft)	Q1/2008	Q1/2007	Differenz
Anlagen-Auftragseingang	85,5	40,5	111%
Anlagen-Auftragsbestand (31.3.)	157,3	70,0	125%
Umsatzerlöse	62,6	63,8	-2%
Bruttoergebnis	24,5	24,2	1%
Bruttomarge	39%	38%	+1 pp
Betriebsergebnis EBIT	8,7	8,2	6%
EBIT-Marge	14%	13%	+1 pp
Ergebnis nach Steuern	5,9	7,6	-22%
Ergebnis pro Aktie (€)	0,07	0,09	-22%
Liquide Mittel (31.12.)	68,6	43,7	57%
Zahlungsmittelzufluss (Free Cash Flow)	12,9	-6,1	-

# Umstellung auf Namensaktien

## Höhere Transparenz und bessere Kommunikation

- Erlaubt eine verbesserte, direkte Kommunikation mit Aktionären
- Wir lernen unsere Aktionäre besser kennen

## Geringere Kosten

- Namensaktien verursachen geringere Kosten, z.B. bei HV-Einladung
- Namensaktien vereinfachen Abstimmung über das Internet

## Sicher, Komfortabel, Kostenfrei

- Aktionäre werden automatisch elektronisch registriert
- Persönliche Daten sind geschützt und sicher
- Aktionären entstehen keinerlei Kosten

## Volle Flexibilität

- Aktien können gehandelt werden wie bisher
- Aktionärsrechte bleiben unberührt

# Ermächtigung zu Rückkauf eigener Aktien

## Was umfaßt diese Ermächtigung?

- Rückkauf eigener Aktien von bis zu 10% des gezeichneten Kapitals

## Wie kann gekauft werden?

- Aktien können über den Aktienmarkt zu +/-10% des durchschnittlichen Schlußkurses erworben werden
- Aktien können über ein öffentliches Angebot zu +/- 20% des durchschnittlichen Schlusskurses erworben werden

## Verwendung der eigenen Aktien zur Vermeidung von Verwässerung

- Erfüllung von Bezugsrechten aus Optionen und Wandelanleihen
- Nutzung Akquisitionswährung

## Aktienrückkaufprogramm

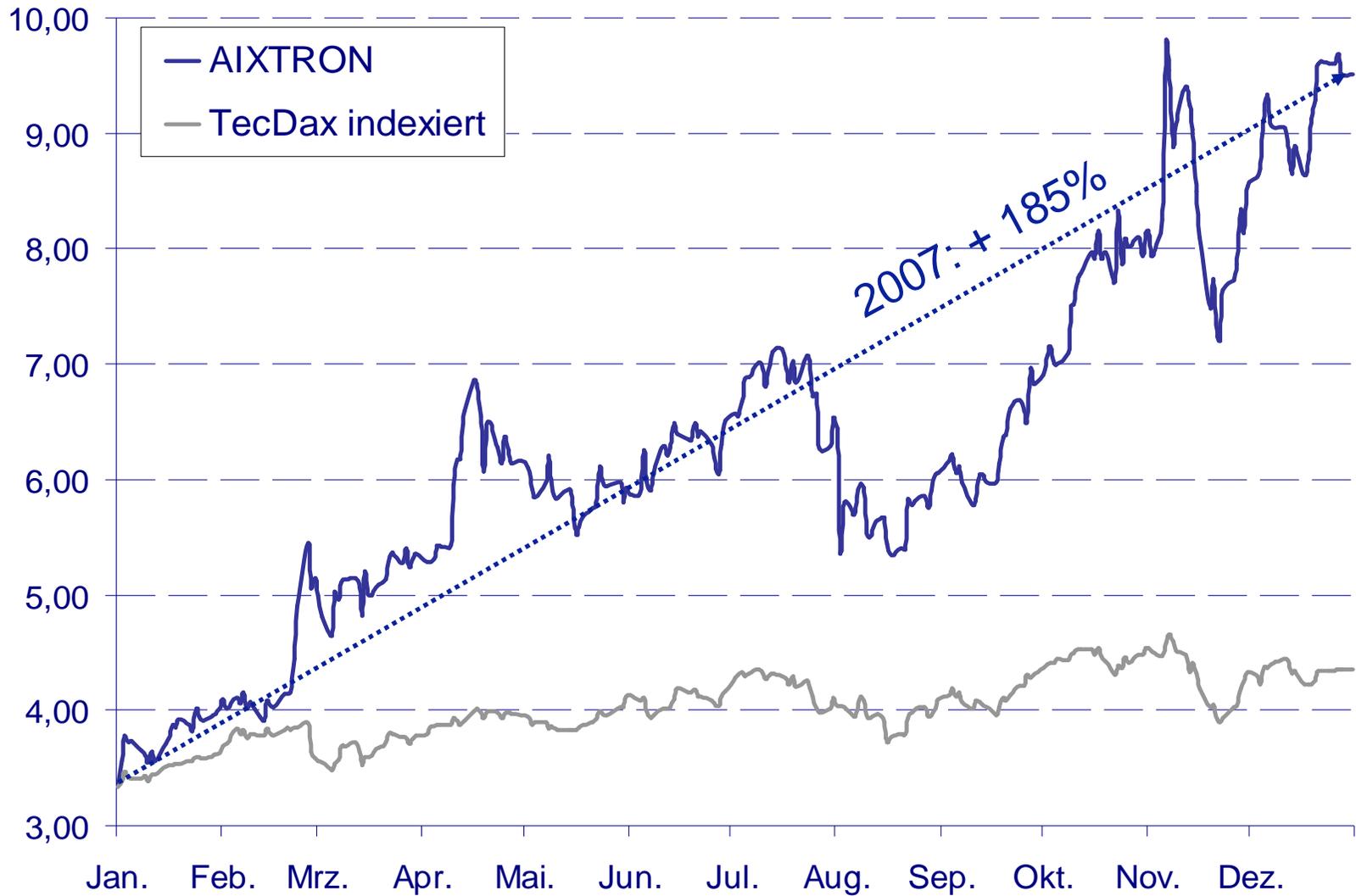
- Es existieren keine Pläne für ein Aktienrückkaufprogramm um Aktien einzuziehen oder zu halten

# Überblick

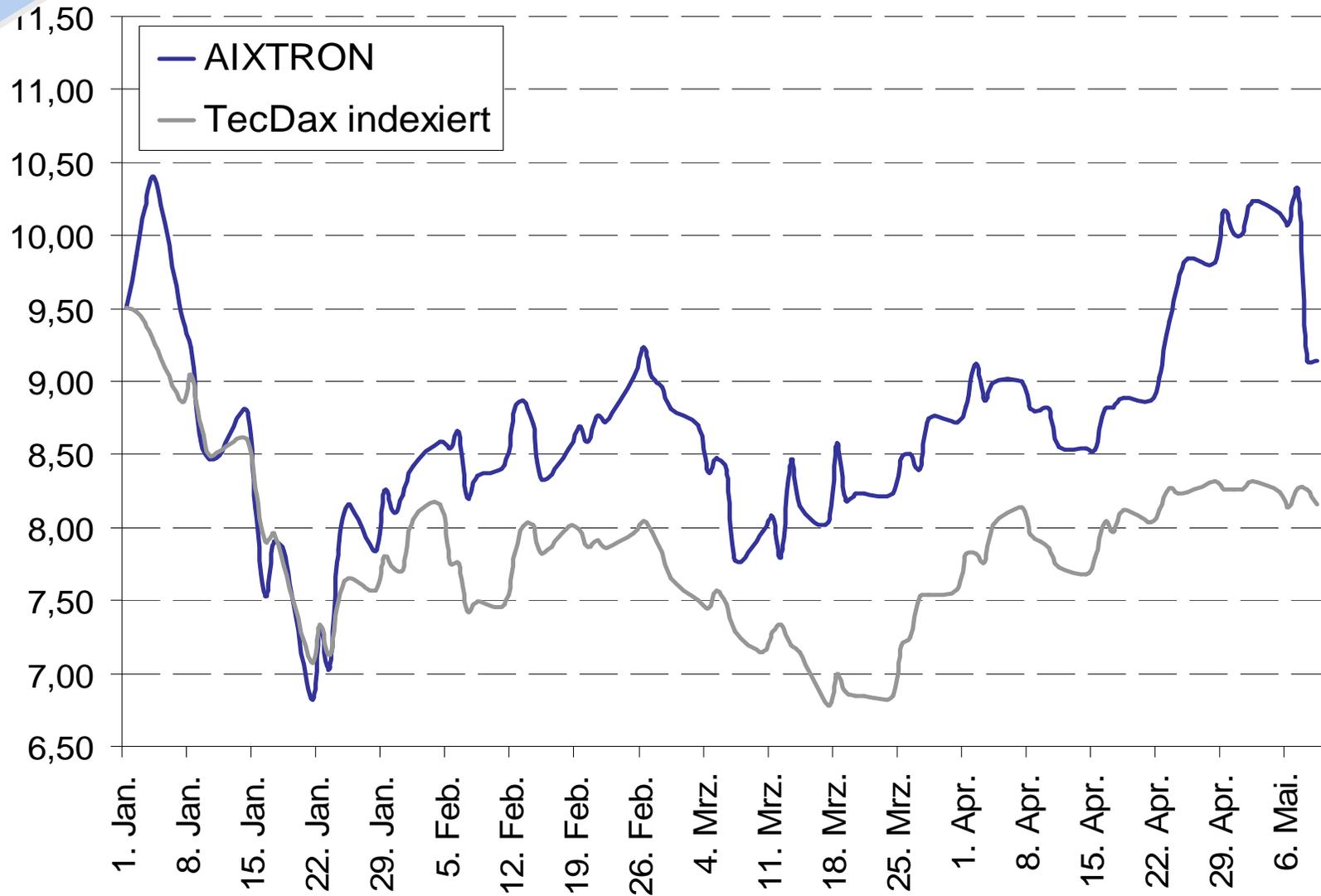
- AIXTRON – Das Unternehmen
- Operative Performance 2007
- Finanzielle Performance 2007
- **Aktienkurs und Ausblick**

*push your*   
**PERFORMANCE**

# AIXTRON Aktienkursentwicklung 2007



# AIXTRON Aktienkursentwicklung 2008



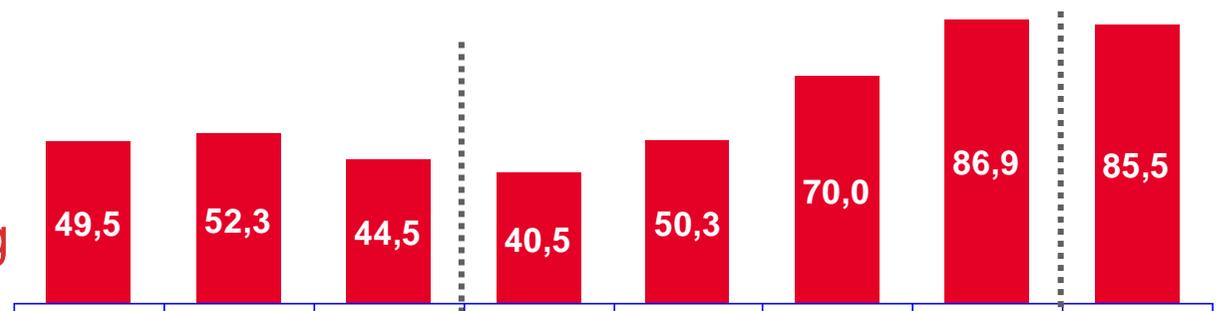
Q1/2008 Update

Aktienkurs und Ausbl.

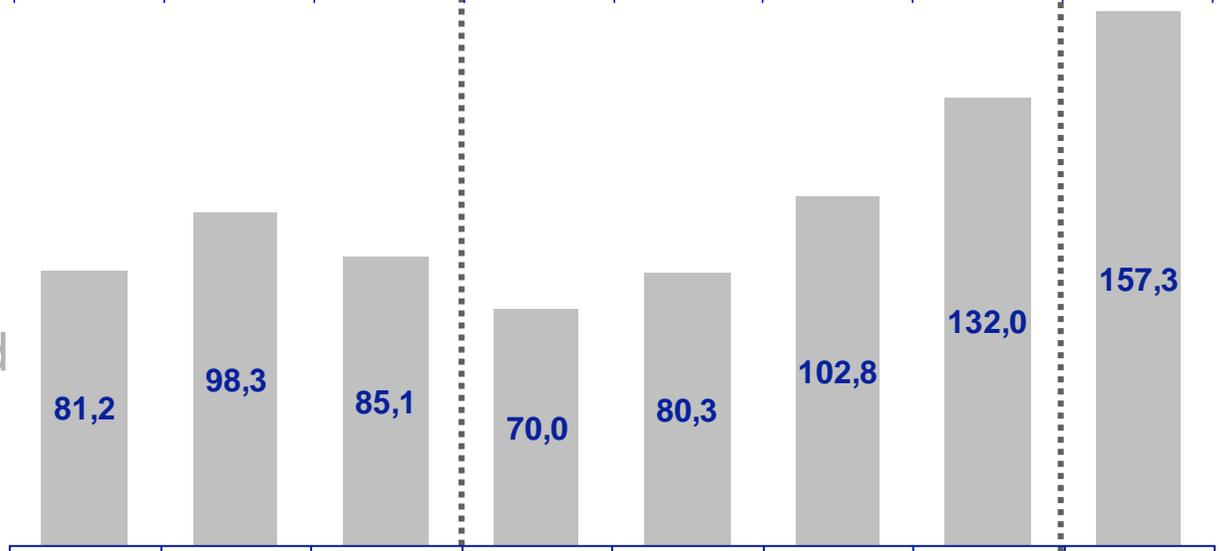
# Gesamtsentwicklung: 24 Monate

(Mio. €)

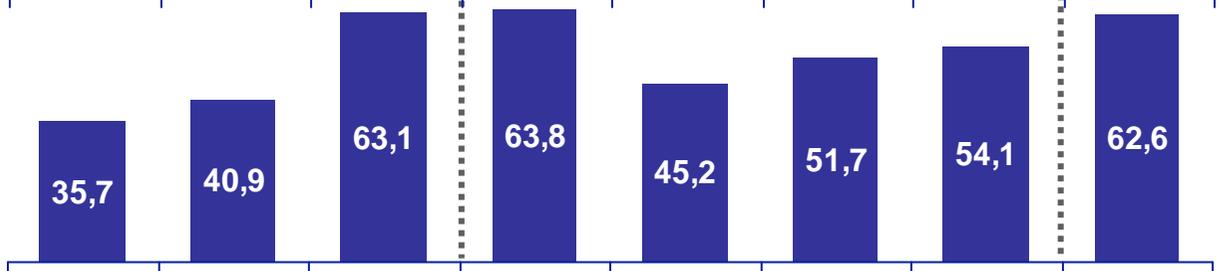
Auftragseingang  
(nur Anlagen)



Auftragsbestand  
(nur Anlagen)



Gesamtumsatz  
(einschl. Service u. Ersatzteile)



Q2/2006 Q3/2006 Q4/2006 Q1/2007 Q2/2007 Q3/2007 Q4/2007 Q1/2008

(in € Mio.)

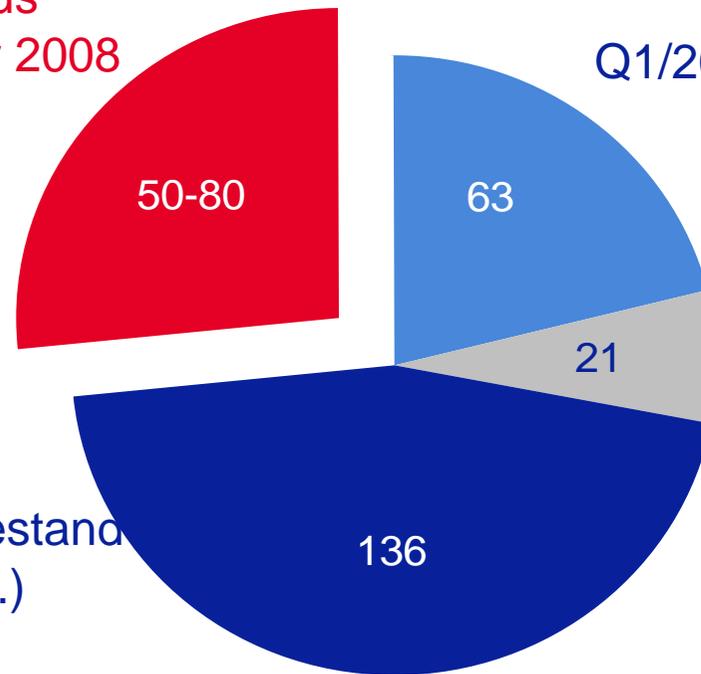
## Zielvorgabe 2008

Benötigter Umsatz aus  
Anlagenaufträgen für 2008

Q1/2008 Ist-Gesamtumsatz

Umsatz 2008 aus  
Anlagen-Auftragsbestand  
(Gesamt: €157 Mio.)

Angenommener  
Umsatz für Service  
u. Ersatzteile  
in Q2-Q4 2008



- **Umsatzvorgabe 2008: €270-300 Mio.**
- **Ergebnisvorgabe 2008: 10-12% EBIT-Marge**

# Neue Technologien – Neue Chancen

## Kurzfristig

- LED Hintergrundbeleuchtung von modernsten LCD-Anzeigen
- LEDs in zunehmenden Anwendungen der Automobilindustrie
- Neue Strassenbeleuchtungen mit LEDs

## Mittelfristig

- Zukünftiger Einsatz der LED-Technik bei der Allgemeinbeleuchtung
- Bauelemente aus Siliziumkarbid (Hybridfahrzeuge, Solar-Energie)
- CVD/ALD: neue NAND/DRAM Speicher-Chip-Anwendungen
- Konzentratorsolarzellen aus Verbindungshalbleitern, III-V Photovoltaik
- Entwicklung von flexiblen Dünnschichttransistoren (TFT), Plastikelektronik

## Langfristig

- Vielversprechende Fortschritte bei OLED-Technologien
- Neue Materialsysteme (Konvergenz von III-V- und Siliziummaterialien)
- Entwicklung neuer Materialien mit Hilfe von Kohlenstoff-Nanostrukturen

*push your*



**PERFORMANCE**